



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% / 40 \%$$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoża nienasiąkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych.

Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej.

Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju

(ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni.

Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całościowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

PRACOWNIA PROJEKTOWA 69 GROUP
Andrzej Wiśniewski

Księży Dwór 67, 13-200 Działowo, tel. kom. 0 668 857 299



PROJEKT BUDOWLANY Poprawa efektywności energetycznej budynku

Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu
Dz. nr 112/1, Zwiniarz 4a, gm. Grodziczno

Inwestor

Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

Tytuł rysunku

Sposób klejenia izolacji termicznej

Branża:

K

Skala:

1:10

Data:

07.2020

Autor: **mgr inż. Andrzej Wiśniewski**
UPRAWNIENIA BUDOWLANE:
Nr ewid. WAM/0143/POOK/08

Rysunek

16